



# 日本高純度化学株式会社

(証券コード: 4973)

## 2015年3月期 第2四半期決算説明資料



# 決算の概況

## 電子部品業界の状況

- ハイエンドスマートフォンの新機種発売を見据えての作り込みが順調に推移、また中国スマートフォン向けも下支えとなった。
- 自動車の電子化が加速し、車載用電子部品の需要増加も追い風となった。
- 国内では消費増税前の駆け込み需要の反動、海外では経済の停滞があるものの、電子部品や半導体については需要は旺盛で、総じて好調に推移した。

## 当社決算の概況

- ハイエンドスマートフォン向けや車載向けマイクロコネクタ用硬質金めっき薬品は技術的な優位性から販売が好調に推移した。
- メモリ基板向けワイヤボンディング用純金めっきは需要が増大し、減少傾向から、やや増加傾向に転じた。

# 2015年3月期 第2四半期の概況

(単位:百万円、%)

決算期	2014/3期	2015/3期				2015/3期 通期予想※2	昨年 実績比
	上半期	1Q	2Q	上半期	前年 同期比		
売上高	5,013	2,339	2,743	5,082	1.4	9,600	4.5
営業利益	545	315	281	597	9.5	1,050	8.1
経常利益	572	343	287	630	10.2	1,100	7.3
四半期純利益	380	240	182	422	11.3	720	7.4
1株当たり 当期純利益※1	64.90円	41.37円	31.26円	72.26円	11.9	123.64円	7.7

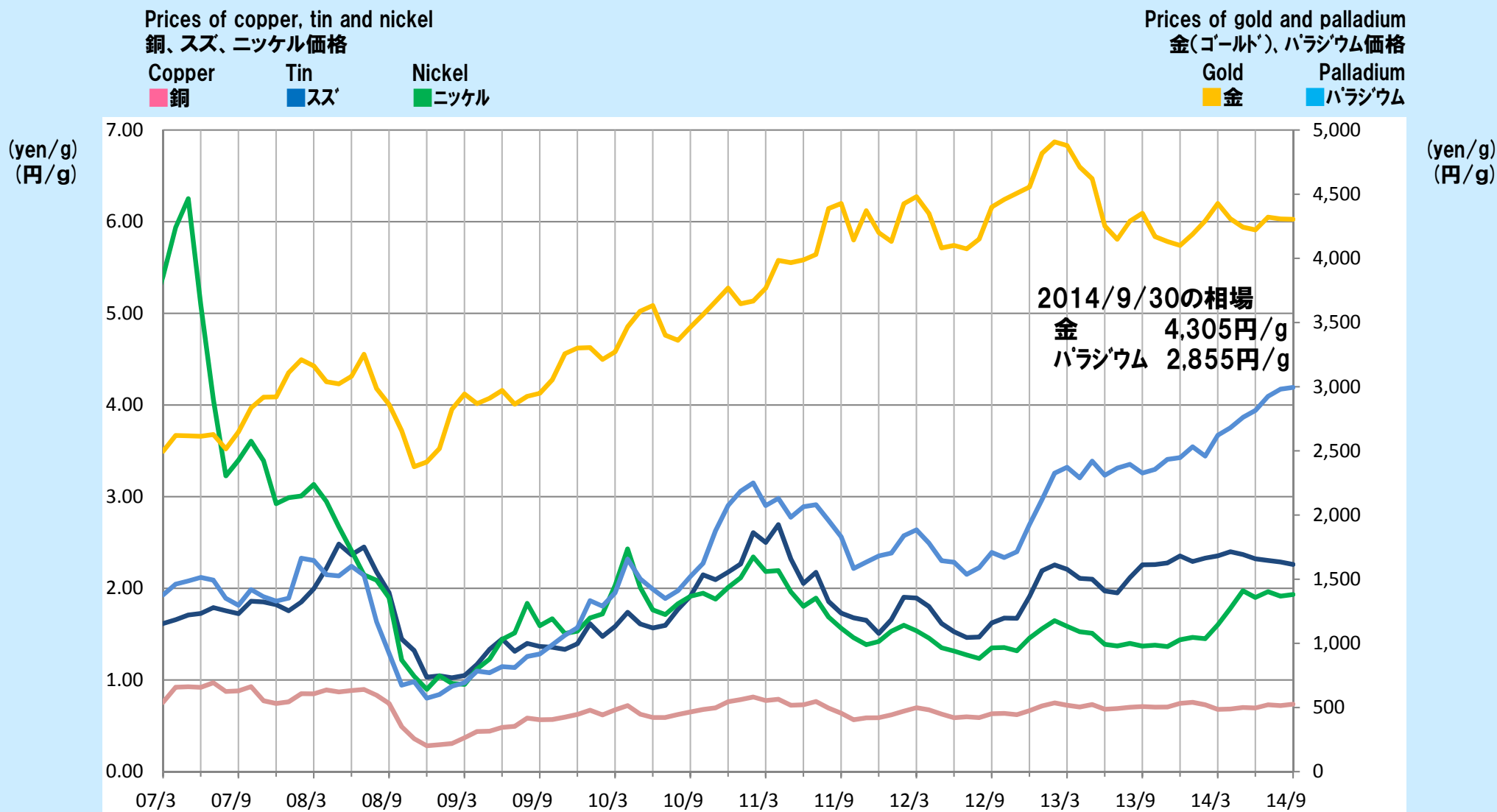
※1 平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

※2 平成26年10月14日付で業績予想を修正しております。

# メタル相場

## Historical metal prices

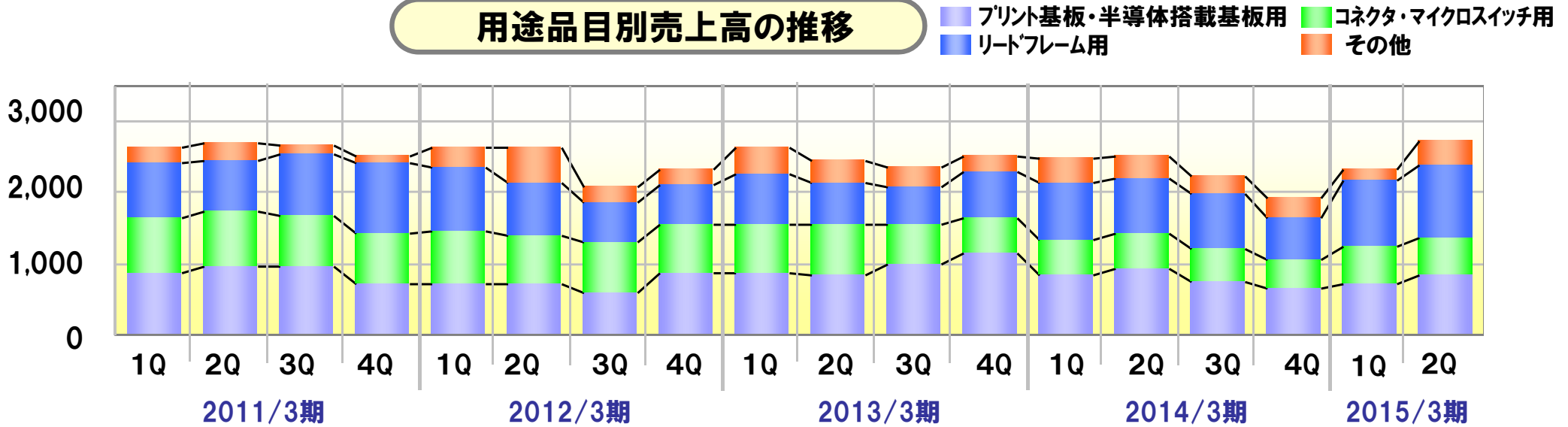
### メタル相場推移



# 用途品目別および地域別売上高の推移

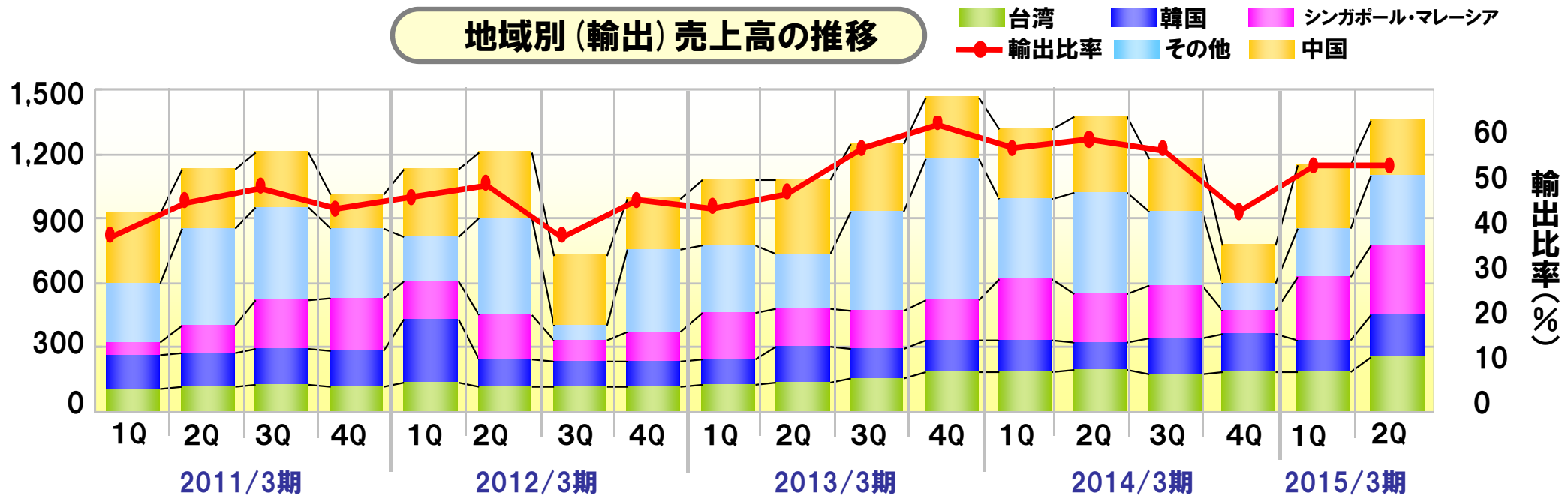
## 用途品目別売上高の推移

売上高(百万円)



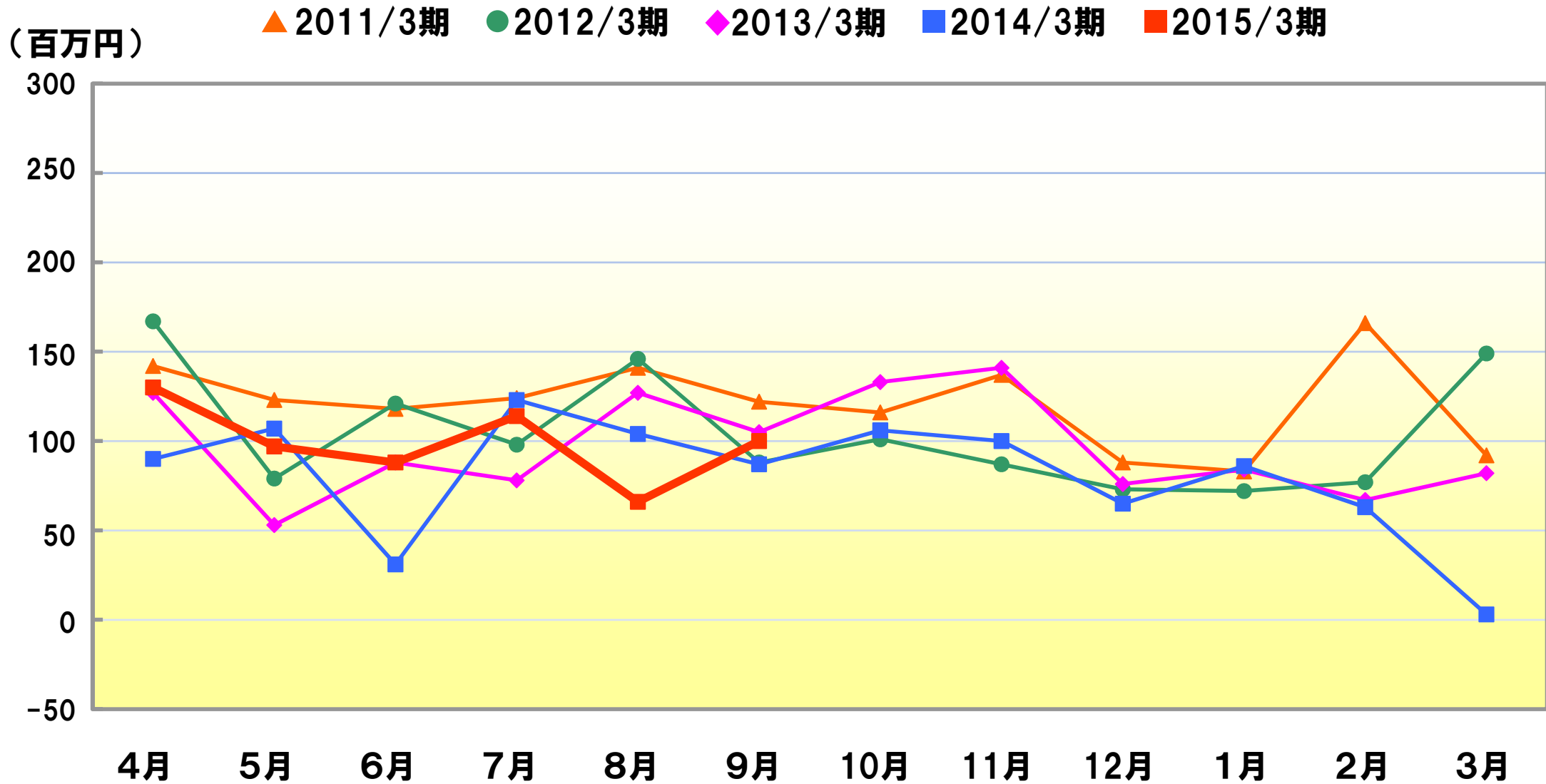
## 地域別(輸出)売上高の推移

輸出高(百万円)

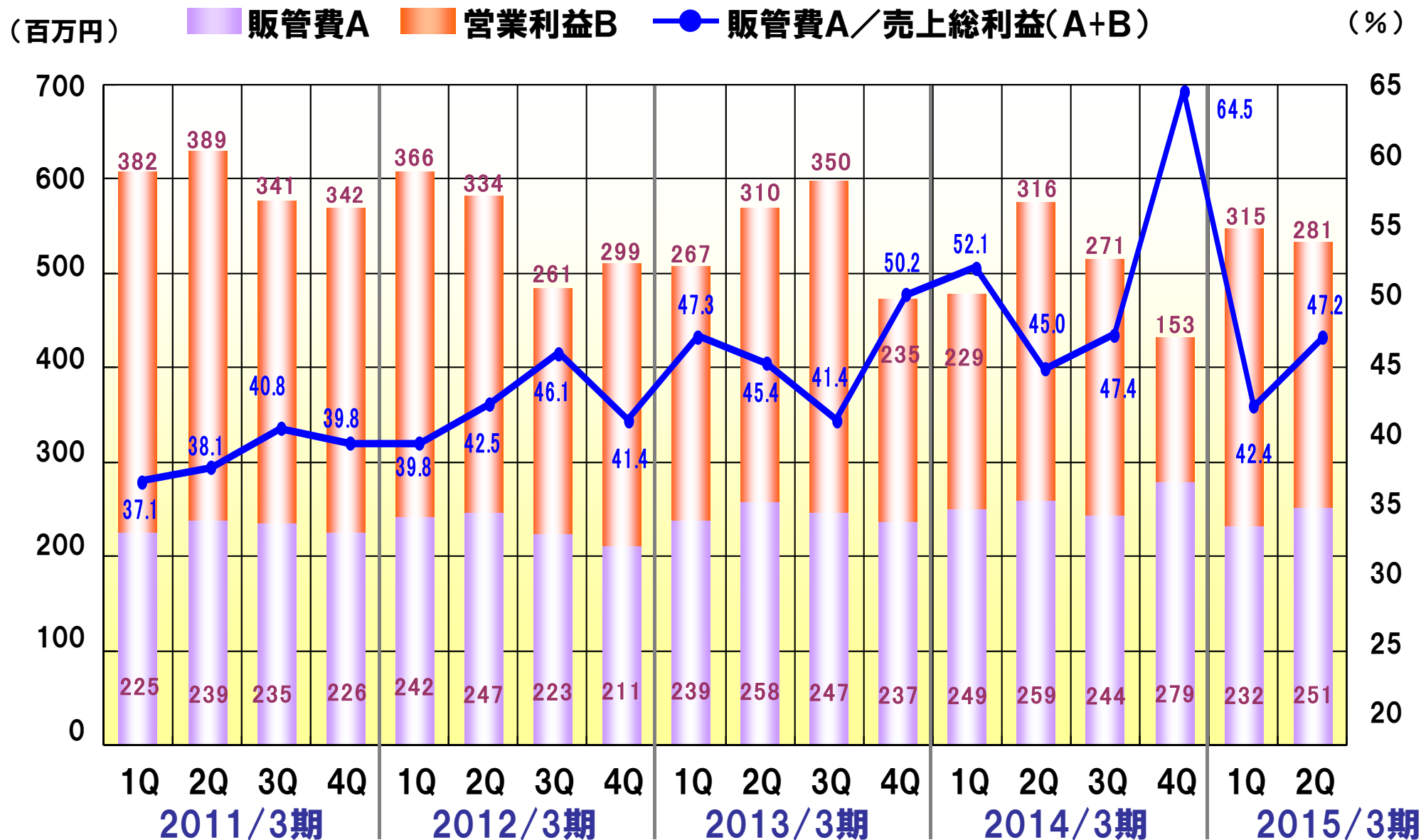


輸出比率(%)

# 営業利益の推移(5ヶ年)



# 販売管理費および営業利益の推移





# 貴金属めっき薬品のラインアップと新製品

めっき方式		用途	2012年までの新製品	2013年以降の新製品
電解	純金 (99.99%以上)		TEMPERESISTシリーズ ICパッケージのワイヤーボンド接続用	
	硬質金 (金Co合金)		OROBRIGHTシリーズ コネクタなどのコンタクト接続用 マイクロコネクタ対応 <b>BAR7</b>	BAR (NI)
	電解Pd		PALLABRIGHTシリーズ リードフレーム用 PPF薄膜化対応 <b>NANO2</b>	
無電解	置換金		IM-GOLDシリーズ 携帯基板のACF接続、はんだ接続用 スマートフォン対応 <b>IB2、CN-I</b>	無電解Ni/IB2X、OM
	還元金		NEOGOLDシリーズ サーバーやデスクトップPC向け MPUパッケージ用 <b>NEO GOLD V (PN)</b>	HY-GOLD CN
	還元Pd		NEOPALLABRIGHTシリーズ スマートフォンなどのCSPパッケージ用	ネオパラブライト2

## 新製品の開発・拡販方針

- (1) 省金化傾向に対応可能な製品の開発・拡販**
- (2) 飛躍的な成長が見込める市場へ参入**
- (3) 特長ある独自技術を使用**

**上記を満たす3つのプロジェクトを掲げて開発・拡販を推進**

# プロジェクト1 車載用省金コネクタめっき

## プロジェクト1

**電解硬質金めっき(BAR7)は携帯端末用途で広く浸透。コネクタメーカーには自動車分野が得意なメーカーもあり、BAR7のさらなる拡販が見込まれる。**

**また、環境規制の強化、安全走行支援のニーズにより、自動車の電子化が加速し、車載用部品が増加傾向。**

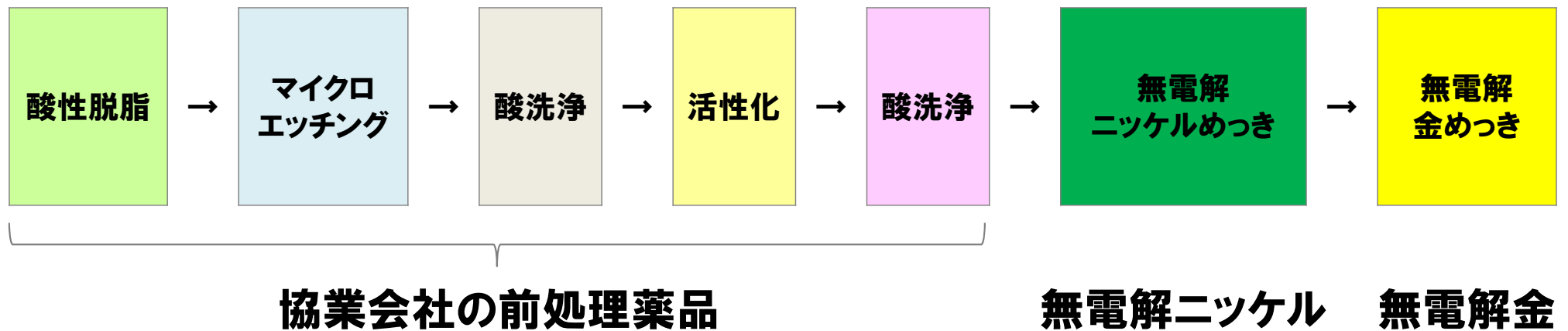
**BAR7の省金効果は、自動車分野でも大きく期待され、コストダウン、耐久性などの要求に対応した製品に改良。**

**用途： 携帯端末用コネクタから車載用コネクタへ**  
**期待効果： BAR7の用途拡大**

# プロジェクト2 中国市場向けENIGプロセス

## プロジェクト2

中国では世界のプリント基板の50%以上を製造しており、ENIG(無電解ニッケル／無電解金)プロセスが普及。一方、中国顧客からはENIG一貫プロセスの要望があり、当社拡販の課題となっていた。



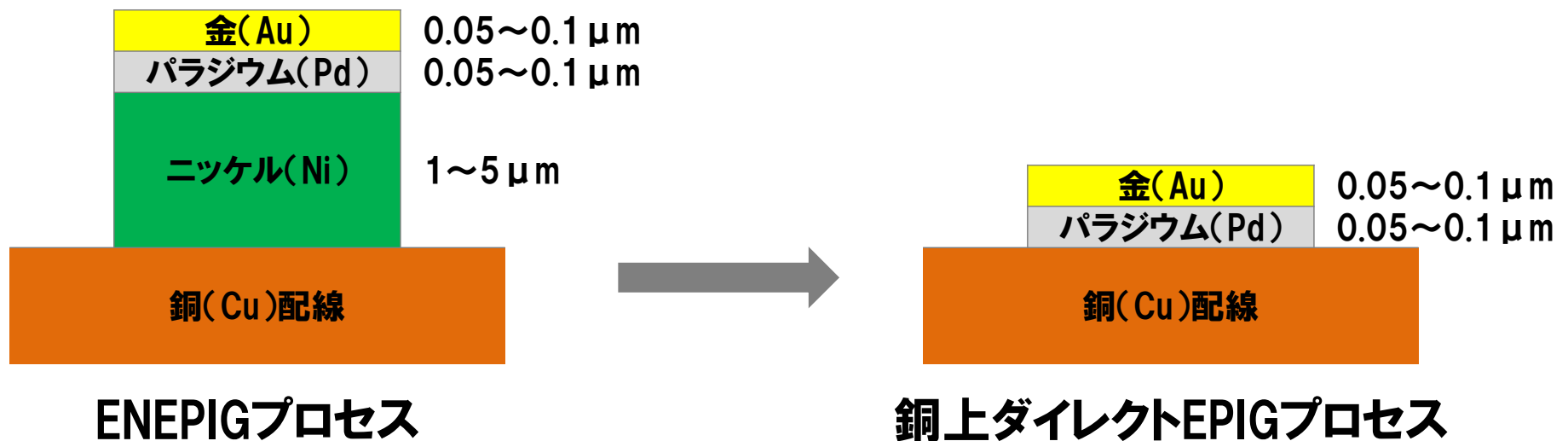
用途： 携帯端末のマザーボード

期待効果： 一貫プロセスの提案によるシェア拡大

# プロジェクト3 銅上ダイレクトEPIGプロセス

## プロジェクト3

次世代スマートフォン向けに銅上ダイレクトEPIG(無電解パラジウム/無電解金)プロセスを新規開発。  
無電解ニッケルを省くことで、配線の高密度化が可能。



用途： 携帯端末のCSP(チップサイズパッケージ)

期待効果： PCより半導体の使用量が多く有望な市場

# 注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2014年9月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

## お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

### 経営企画部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>